

環境負荷化学物質含有量

環No.2019-02
2019年4月11日

製品名 : MKY02
部品質量(mg) : 260

株式会社ステップテクニカ 管理部
E-mail kanri_step@steptechnica.com

部位	素材・化学物質	CAS No.	質量 (mg)	部位含有率 (wt%)	全体含有率 (wt%)	使用目的
チップ	シリコン(Si)	7440-21-3	18.9704	99.3527	7.2963	素子材料
	ヒ素(As)	7440-38-2	1.00E-04	0.0005	0.00E+00	ドーパント
	ホウ素(B)	7440-42-8	9.00E-04	0.0047	3.00E-04	ドーパント
	リン(P)	7723-14-0	2.70E-03	0.0142	1.00E-03	ドーパント
	チタン(Ti)	7440-32-6	3.29E-02	0.1725	1.27E-02	回路形成
	タングステン(W)	7440-33-7	8.60E-03	0.0448	3.30E-03	回路形成
	銅(Cu)	7440-50-8	2.00E-04	0.0013	1.00E-04	回路形成
	アルミニウム(Al)	7429-90-5	7.82E-02	0.4093	3.01E-02	回路形成
チップマウント	銀(Ag)	7440-22-4	1.5324	77	0.5894	導電性材料
	アクリル樹脂	---	0.398	19.9998	0.1531	接合材料
	エポキシ樹脂	---	0.0597	3.0002	0.023	接合材料
リードフレーム	銅(Cu)	7440-50-8	109.0576	96.0733	41.9452	フレーム材料
	鉄(Fe)	7439-89-6	2.5674	2.2617	0.9875	フレーム材料
	銀(Ag)	7440-22-4	1.89	1.665	0.7269	銀メッキ
ワイヤ	金(Au)	7440-57-5	1.283	100	0.4935	配線
外部端子メッキ	スズ(Sn)	7440-31-5	8.7338	100	3.3591	端子表面処理材料
パッケージ	エポキシ樹脂	---	15.8076	13.7	6.0799	封止樹脂材料
	有機リン化合物	---	1.1538	1	0.4438	封止樹脂材料
	シリカ(SiO2)	60676-86-0	98.0765	85	37.7217	封止樹脂材料
	カーボン(C)	1333-86-4	0.3462	0.3	0.1331	封止樹脂材料
含有量合計			260		100	